

## 2020 年度・共同研究公募制度 募集要項

① 制度の趣旨	東京エレクトロン(TEL)は『最先端の技術と確かなサービスで、夢のある社会の発展に貢献します』という基本理念のもと半導体・FPD 業界の発展に貢献してまいりました。これまでも数多くの大学・研究機関と共同研究を実施し、産学連携に積極的に取り組んでいます。本制度では、当社の企業活動を通じて、社会の発展に貢献する研究を幅広く募集いたします。
② 公募対象研究者	日本国内の大学および大学院(国公立、私立問わず)、高等専門学校、その他公的研究開発機関のいずれかに所属し、該当機関において自律的な研究をおこなうことが可能な研究者を対象とします。営利事業を目的とした個人および法人に所属する研究者は対象といたしません。また、研究者がすでに他の機関から同一課題・目的で資金提供などを受けている研究テーマは応募対象に含まれません。
③ 研究対象領域	当社の事業である半導体・FPD の製造技術やデバイス・ウェーハ製造プロセスに必要となる、ニーズおよびシーズ技術と適合する研究テーマが対象となります。  詳細は「別表 I 研究対象領域詳細」を参照ください。
④ 共同研究期間	2021 年 4 月 1 日より 1 年を単位とし、最長 3 年間です。 1 年ごとに共同研究契約を締結いたします。
⑤ 研究費用	共同研究の規模に応じて、次の 3 区分を設けます。 研究資金は、区分に基づいた範囲で提供いたします。  ① 大型研究 年間 1,500 万円以内、3 年間総額 4,500 万円を上限  ② 中型研究 年間 500 万円以内、3 年間総額 1,500 万円を上限  ③ 小型研究 年間 100 万円以内、3 年間総額 300 万円を上限  なお、上記費用は間接経費および消費税を含んだ合計金額です。

<p>⑥ 応募方法</p>	<p>応募用紙（題目「研究計画提案書」）に必要事項を記入し、PDF ファイルをメールに添付し以下宛先までお送りください。</p> <p>メールタイトル          【2020年度 東京エレクトロン 共同研究公募提案書：研究機関名・氏名】          （研究機関名と氏名をお書き添えください。）</p> <p>宛先 <a href="mailto:telstdkyokenkoubo@tel.com">telstdkyokenkoubo@tel.com</a></p> <p>受付開始 2020年10月1日（木）</p> <p>締め切り 2020年10月16日（金）必着</p>
<p>⑦ 審査と選定</p>	<p>提出いただいた「研究計画提案書」に基づき、当社選考委員が書類審査、選考をおこないます。書類審査を通過された場合は、引き続き最終審査として研究計画の詳細について審査いたします。最終審査にあたり、必要に応じて秘密保持契約を締結の上、当社担当社員と研究内容、実施計画、研究資金の妥当性などについて協議させていただく場合があります。共同研究契約の締結をもって正式採択といたします。</p>
<p>⑧ 審査基準</p>	<p>当社の技術ニーズまたはシーズとの関連性があり、当社の技術シーズを発展させ得る研究や、アカデミックならではの独創的な視点、発想により、将来的な当社事業領域発展への貢献が期待される提案を歓迎いたします。</p> <p>審査に際し、過去の実績は必ずしも重要ではなく、提案の内容および計画の妥当性や将来性、継続性に重点を置き審査をおこないます。最終判断は、全体研究予算も鑑みての選考となりますのでご注意ください。</p>
<p>⑨ 秘密の保持</p>	<p>提案いただいた「研究計画提案書」に記入された内容は、当社内部で審査選考の目的にのみ使用いたします。原則として秘密保持契約は締結せず、当社に開示できると判断した情報のみ開示ください。</p>
<p>⑩ 審査結果の通知</p>	<p>審査結果は1次審査、最終審査ともに、すべての応募者に対し電子メールにてご連絡いたします。</p>

<p>11 共同研究契約書の締結</p>	<p>共同研究の開始に先立ち、各種の契約締結は、応募者が所属する組織と当社間で締結いたします。</p> <p>契約有効期間は各研究年度を基準とし、単年度の契約といたします。共同研究契約書は、原則、当社指定の『共同研究契約書（雛型）』を用いますが、合理的な理由があり両者協議の上で合意した場合は、応募者側が定める雛型を用いることも可能です。</p>
<p>12 選考プロセス</p>	<p>共同研究開始までの選考プロセスは以下の予定です。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 応募期間 2020年10月1日（木）から10月16日（金）</li> <li>・ 1次審査結果の通知 2020年11月30日（月）まで ※1次審査通過の皆さまには、最終審査にあたり別途詳細な研究計画の提出をお願いします</li> <li>・ 最終審査結果の通知 2021年1月中旬まで ※最終審査通過の皆さまとは共同研究契約の手続きを進めさせていただきます</li> <li>・ 共同研究契約の締結 2021年4月1日（同日に遡及して契約可能）</li> <li>・ 共同研究の開始 2021年4月1日</li> </ul>
<p>13 共同研究成果の帰属</p>	<p>共同研究の成果として得られた知的財産権の取り扱い、取得した設備の取り扱い、成果物の取り扱いなどについては、双方で協議の上、「共同研究契約書」において文書化いたします。</p> <p>詳細は当社『共同研究契約書（雛型）』をご参照下さい。</p>

<p>14 報告会および報告書</p>	<p>適切な頻度での研究進捗報告と成果報告書の提出をお願いします。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 進捗報告会（必要に応じて随時開催）</li> <li>・ 中間報告会（毎年 10 月頃開催）</li> <li>・ 期末報告会（毎年 1 月から 3 月頃開催） ※期末報告会で翌年度の継続審査を実施します</li> <li>・ 成果報告書（毎年 3 月頃提出）</li> </ul>
<p>15 個人情報の取り扱い</p>	<p>応募時にご提供いただいた個人情報は、本制度の業務に必要な範囲に限定して、適切に利用いたします。また、本制度を実施する目的で東京エレクトロングループ各社において共同利用させていただきます。</p> <p>当社における個人情報の取り扱いについては以下をご参照ください。</p> <p><a href="https://www.tel.co.jp/privacy/">https://www.tel.co.jp/privacy/</a></p>
<p>16 お問い合わせ先</p>	<p>公募に関するご質問は下記宛先までメールにてお願いします。</p> <p>メールタイトル：【共同研究公募質問：研究機関名・氏名】 （研究機関名と氏名をお書き添えください。）</p> <p>宛先メールアドレス：<a href="mailto:telstdkyokenkoubo@tel.com">telstdkyokenkoubo@tel.com</a></p>

別表 I 研究対象領域詳細

大分類	中分類	研究・技術領域
理工学全般	薄膜、表面界面物性	ナノ・原子スケールの材料構造化技術と物性反応制御技術 エッチング・成膜・表面改質技術 自己組織化材料技術
	構造・機能材料	半導体デバイス材料の構造化技術（高誘電体、低誘電体、 低抵抗配線電極材、バリア膜、選択成長膜、マスク材など）
	プラズマ応用技術	プラズマ発生源とプラズマ制御技術 プラズマ状態の計測・診断技術 中性粒子・負イオン応用のプロセス技術
	シミュレーション工学	空間場（熱流体・電磁場・希薄気体・プラズマなど）の 定常・非定常・過渡応答シミュレーション技術
化学	分析・計測技術	ナノ・原子スケールの表面及び界面の分析・計測技術 半導体デバイス材料の構造・物性分析・計測技術
	化学プロセス	洗浄・酸化・還元プロセス技術 触媒応用プロセス技術 気液固相の反応プロセス技術
	新材料	有機・無機複合材料による新機能技術 2次元構造化材料（MoS <sub>2</sub> 、グラフェン等）技術 プリカーサ設計・供給技術

工学全般	生産技術	超精密加工、積層造形、接合、表面処理等の製造加工技術 熱伝達、希薄ガスなど流体制御技術、
	新材料	機能性複合材料、高耐熱性材料、高耐食性材料、 高耐プラズマ性材料等の構造化・成形技術 軽量化材料技術
	センサ・制御技術	各種センシング技術 広帯域データ通信制御技術
	コンピュータ・ 知能情報処理	高速・大容量画像処理技術 分散データ処理技術 装置生産性や開発業務効率を向上させる AI（機械学習、協調 学習）、マテリアルズ・インフォマティクス（MI）、 DX 技術、量子コンピュータを用いた科学計算技術
環境工学  (持続可 能・低炭素 社会 実 現)	創エネルギー	革新的高効率エネルギー変換・利用技術（熱エネルギー等） 革新的断熱、伝熱制御技術
	省エネルギー	電力／動力変換システムの省エネ・高効率化関連技術 省電力データ通信・情報処理技術
	カーボンニュートラル	高効率、低エネルギーでの温室効果ガス分離・吸着技術